

## ソフトバンク株式会社の“ソフトバンク”ならびに“ワイモバイル”向け Android One のスマートフォン「S5」を商品化

シャープは、ソフトバンク株式会社の“ソフトバンク”ならびに“ワイモバイル”向けAndroid One のスマートフォン「S5」を商品化します。

本機は、Google™の最新OS Android™ 9 Pieに対応しました。毎月のセキュリティアップデート※1に加え、アップグレードされるたびに最新のOSが提供される※2ので、長く安心してご利用いただけます。また、「Google アシスタント™」や「Google フォト™」、「Google マップ™」など人気のGoogleのアプリを搭載しています。

縦横比18:9の約5.5インチ フルHD+(2,160×1,080画素) IGZO液晶ディスプレイ※3を搭載し、高精細な表示と高い省エネ性を両立。画面上により多くの情報を表示できるので、ウェブサイトやSNSなどの閲覧がさらに快適になりました。また、従来機より画面サイズをアップする一方、消費電力は約21%※4削減しました。

メインカメラには、ピクセル(画素)サイズを従来機比約25%※4大型化したイメージセンサーと、F値2.0の明るいレンズを採用。取り込める光の量が約1.5倍※4に増えることから、薄暗い場所でもノイズが抑えられ、質感や色味がよりリアルな画像を撮影できます。

本体ボディには剛性の高いアルミ素材を採用しました。落下試験をクリアした耐衝撃設計※5に加え、防水・防塵※6にも対応しているので、日常の様々なシーンで便利にお使いいただけます。

品名	スマートフォン
愛称	Android One
形名	S5
発売時期	2018年12月下旬以降予定

### ■ 主な特長

1. Android 9 Pieに対応。毎月のセキュリティアップデートに加え、アップグレードされるたびに最新のOSを提供
2. 縦横比18:9の約5.5インチ フルHD+(2,160×1,080画素) IGZO液晶ディスプレイを搭載
3. ピクセルサイズを大型化したイメージセンサーと、F値2.0の明るいレンズを採用
4. 剛性の高いアルミ素材を採用。耐衝撃設計に加え、防水・防塵にも対応

※1 発売開始から3年間、アップデートを実施するものです。

※2 発売開始から24カ月間に最低1回以上アップデートを実施するものです。

※3 IGZO液晶ディスプレイは、株式会社半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化したものです。

※4 当社2017年度モデル<Android One S3>との比較。

※5 米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

※6 IPX5/IPX8の防水、IP6Xの防塵性能。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

ソフトバンク (<https://www.softbank.jp/mobile/products/smartphone/android-one-s5/>)

ワイモバイル (<https://www.ymobile.jp/lineup/androidone-s5/>)

シャープ (<http://www.sharp.co.jp/k-tai/index.html>)

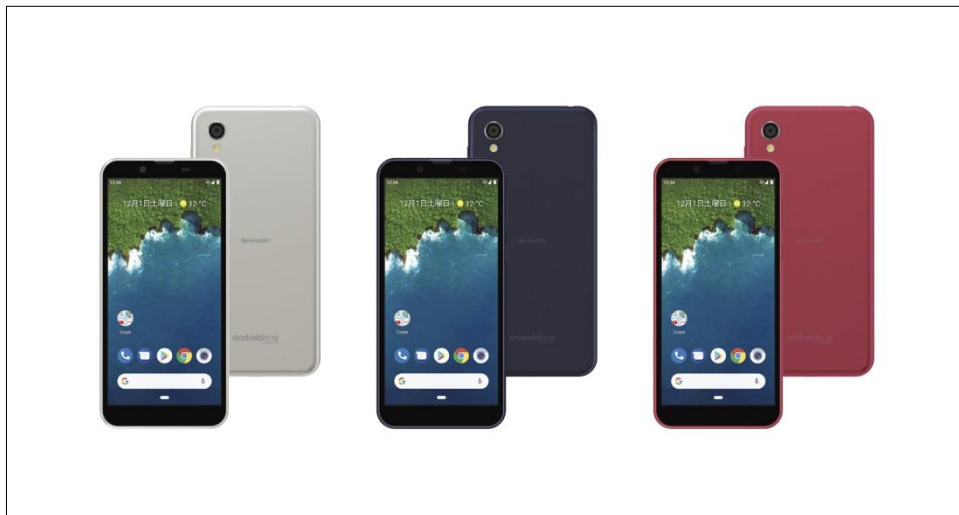
### 【お問い合わせ先】

お客様：ソフトバンクカスタマーサポート 0800-919-0157(フリーコール)  
ワイモバイルカスタマーセンター 0570-039-151(有料)

■ 仕 様

品 名	スマートフォン
愛 称	Android One
形 名	S5
OS	Android™ 9 Pie
サ イ ズ / 質 量	約148×約71×約8.1mm/約149g
C P U	Qualcomm® Snapdragon™ 450 (SDM450) 1.8GHz/オクタコア
内 蔵 メ モ リ	RAM 3GB、ROM 32GB
デ ィ ス プ レ イ	約5.5インチフルHD+ (2,160×1,080画素) IGZO液晶ディスプレイ
ア ウ ト カ メ ラ	有効画素数 約1,200万画素 CMOS 裏面照射型
イ ン カ メ ラ	有効画素数 約800万画素 CMOS 裏面照射型
W i - F i ®	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
B l u e t o o t h ®	Ver. 4.2
バ ッ テ リ ー 容 量	2,700mAh (内蔵電池)

- Google、Android、Google Playおよびその他のGoogleサービスのマークは、Google LLC の商標です。
- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- Qualcomm及びSnapdragonは米国及びその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。
- Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。



シャープ ソフトバンク株式会社の“ソフトバンク”ならびに“ワイモバイル”向けAndroid Oneスマートフォン <S5>  
(左から、クールシルバー、ダークブルー、ローズピンク)

- 画面はハメコミ合成です。
- 開発中につき、発売時にデザインや仕様変更になる可能性があります。最終の仕様はウェブサイトに掲載します。  
(<http://www.sharp.co.jp/k-tai/index.html>)